

愛普科技股份有限公司

2024.05.07 法人說明會

林郁昕 財務長

大家午安，我是愛普科技財務長林郁昕，歡迎參與愛普科技法人說明會，在會議的初段，我們將進行本公司 2024 年第一季的財務狀況及業務報告，簡報過後會進入問答階段，線上參與的投資朋友可在畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆。

免責聲明部分再請各位留意。

法說會主要會分成 2024 年第一季財務數字重點說明、營運狀況以及未來展望，由團隊報告說明後進行 Q&A，今日的與會團隊除了我之外，有陳文良董事長、洪志勳總經理以及劉景宏資深副總經理。

首先由我這邊進行財務狀況報告。

首先說明 2024 年第一季的合併損益情形，愛普第一季合併營收受到季節性需求因素影響及客戶庫存控制而較去年第四季下滑，合併營收金額為新台幣 7.48 億元，較去年第四季減少 36%，YoY 則與去年同期相當，增加 3%；毛利金額為 3.4 億元，QoQ 減少 32%，YoY 則增加 18%；第一季毛利率為 46%，QoQ、YoY 分別增加 2 個百分點及 6 個百分點，除了因 IoT 事業部產品組合的有利變化之外，AI 事業部營收比重提升亦使得整體毛利率提高。

本季營業費用為 2.4 億元，金額季增 6%，較前季增加約 1,400 萬元，但若排除預期信用減損損失及迴轉利益的影響，營業費用季減約 1,800 萬元，主要來自於研發費用的減少，

因部分委託研究費是依照專案執行進度及投入來認列，研發費用因而有短期的波動，而長期來看，隨著各項專案持續的開展，包括研發工程人力擴增及光罩、探針卡等等的投入，都會使研發費用持續增加。

營業利益為 1.1 億元，QoQ 金額減少 63%，主要是受營收減少、營業費用增加的影響；YoY 金額則略增 3%。本季營業利率為 14%，QoQ 減少 10 個百分點，YoY 營業利率則維持在相同水準。

業外收支部分，第 1 季業外收入為 3.6 億元，主要來自於兌換利益 3.2 億元、利息收入 1 億元及金融資產評價損失 4,700 萬元。兌換利益來自於第一季底美金兌新台幣匯率升值 4.2% 的影響。因本公司 GDR 募資資金除了研發投入之外，尚未大幅動撥，加上既有的外幣資金、應收付款等淨外幣部位，持續會受到匯率波動的影響。再次跟投資先進說明，美金匯率的變化主要是造成本公司帳面金額的波動，對本公司並沒有實質的影響。排除 GDR 相關兌換損益及所得稅影響數的擬制設算資料會在下一頁做說明。

金融資產評價損失 4,700 萬元，是來自於海寧長盟的評價利益 700 萬元及來頡科技市價評價損失 5,400 萬元的淨影響數。本公司持有來頡科技 4 百萬股，在今年 1 月 31 日該公司市價為 178 元，相較於去年底的市價 191.5 元，因而認列了公允價值變動的損失。而本公司在 1 月 31 日成為來頡科技的董事，陳文良董事長也成為該公司董事長，是以愛普對來頡的股權投資在 1 月 31 日起轉為採用權益法來認列投資損益。

第一季稅前利益為 4.7 億元，所得稅費用為 1 億元，包含第一季認列未分配盈餘加徵 5% 稅額約 830 萬元，所得稅有效稅率為 21.5%。稅後淨利金額為 3.7 億元，QoQ 維持相同水準，YoY 則增加 490%，淨利率為 49%，單季每股盈餘為 2.27 元。

如果排除 GDR 未支用資金所產生的兌換損益後，2024 年第一季業外淨收入為 1.3 億元，主要來自於利息收入 1 億元、既有美金淨部位兌換利益 8,300 萬元及金融資產評價損失 4,700 萬元。排除 GDR 相關匯率影響後，第一季淨利金額將為 1.8 億元，QoQ 減少 70%，YoY 增加 77%，淨利率為 24%，QoQ 減少 28 個百分點、YoY 增加 10 個百分點。擬制調整後每股盈餘為 1.1 元。

合併資產負債表部分，季底總資產為 128 億元，較去年底增加 3 億元。其中，現金及約當現金 41.5 億元、按攤銷後成本衡量之金融資產 52 億元，總計金額約 93.5 億元，合計占總資產的 73%。本公司於第一季承做三個月以上的定期存款，依會計原則帳列按攤銷後成本衡量之金融資產，該科目的餘額也因此增加，相對的，現金及約當現金就會減少。而與去年底合計數相較，淨增加 4.8 億元，主要是來自於營業活動應收帳款的回收所帶來的淨現金流入。第一季底應收帳款 3.7 億元，較去年底減少 1.9 億元，主要是銷貨季節性減少的連帶影響。第一季底存貨金額為 9.1 億元，較去年底增加 6,100 萬，上升 7%，目前庫存水位正逐步地回升至合理水位。另外如剛剛損益表業外收支的說明，本公司在 2024 年 1 月底將對來頡科技的投資由透過損益按公允價值衡量之金融資產轉列為採用權益法之投資，也導致該兩科目金額的大幅變動。

第一季底的總負債為 21.8 億元，負債比率為 17%，較去年底增加 10 億元，主要是增加 11.35 億元的應付股利、1 億元的應付所得稅及償還 2 億元短期借款的淨影響數。

股東權益總金額為 106 億元，因第一季決議盈餘分配現金股利 11.35 億元，因而較去年底 113 億元減少 7 億元。每股淨值為 65.51 元，因盈餘分配較去年底 69.89 元減少，但較去年第一季底的 61.16 元增加 4.35 元。

以上是就財務資訊的相關說明，接下來的時間由洪志勳總經理說明營運狀況，謝謝！

洪志勳 總經理

謝謝財務長。各位投資先進大家好，接下來由我為大家報告第一季的營運狀況。

2024 年第一季的營收為 7.48 億元，相較前季減少了 35.7%，主要是第一季工作天數較少以及新年春節過後需求較弱，是傳統淡季的影響。另外，Connectivity 客戶在最近一波備貨後有一些庫存待去化，也影響到了第一季的營收。

本季營收主要貢獻還是來自於 IoT BU，AI BU 在新世代的礦機從第一季起進入量產，營收在 Wafer Sales 挹注下較前季有回升。

接下來我就兩個事業部在 2024 年第一季的營運狀況分別來為大家說明。

首先我們來看 IoT 事業部。

本季營收為 6.5 億元，較前季減少 42.6%，主要是季節性因素的影響，對比去年同季則是略增 4%。

那 IoT 事業部的主要應用領域分為三塊：Connectivity、Wearable 及 Video/ Audio/

Others。

Connectivity 的主要應用是蜂巢式網路，也就是 4G/ 5G modem。Wi-Fi、Bluetooth 以及部分的 industrial IoT，在本季 IoT BU 營收中占比約 42%。這部分較前季減少了 55.7%，主要是因為先前提到的部分的客戶庫存控制，而拉貨減少的影響。這些客戶的庫存消化可能需要一到兩個季度的時間。

另外在穿戴裝置的部分，本季營收較上季減少了 28.7%，占本季 IoT 營收為 29%，營收的減少主要是季節性的因素。在穿戴裝置的市場我們看到是持續增長的，隨著客戶產品的功能愈來愈複雜，對記憶體的需求也較以往增加，那尤其是在中高階產品對記憶體的需求，在低功耗以及高效能的要求也愈來愈嚴格，這部分我們持續有新的解決方案協助客戶提升競爭力。我們對於愛普在這個市場的長期領先地位是相當有信心的。

另外在 Video/ Audio/ Others 的應用這邊，營收較前季減少了約 25%，本季營收占比 29%，其中以 Smart Home 以及小型 Display 相關的應用貢獻比較大。那 Smart Home 的產品在 AI 以及連網應用的帶動之下，不僅帶動了需求的增加，對記憶體容量的需求也隨著增加。IoTRAM™ 在 Display 領域的應用也有增加的趨勢。

此外，我們之前法說會有跟各位先進提到過 Silicon Capacitor，也就是我們的 S-SiCap™，導入在嵌入 substrate 的設計當中，這個設計主要是應用在 HPC 產品的封裝上面，可以提升 SoC 的穩定度並增加產品的效能。HPC 的產品，比如說是：GPU，功耗越來越大、速度越來越快，對電容的需求也越來越大。嵌入式的 Substrate 是一個比較新的做法，我們可以進一步地增加電容，來提高系統的性能。目前這些專案都在順利地進行當中，也有

愈來愈多的客戶關注，雖然開發的時程比較長，對營收還沒有明顯的貢獻，但是我們對於 S-SiCap™ 在 HPC SoC 封裝領域的長期發展，我們是很有信心的。

接下來我們來看 AI 事業部。

第一季營收台幣 9,800 萬，季增 216%，較前季成長主要是新世代礦機進入量產的 Wafer Sales 貢獻，IP Licensing 的收入也因為本季有專案進度達成認列營收而較前季有顯著地增加。

AI 事業部主要的營收分為 IP licensing、VHM™ 以及 S-SiCap™ Interposer Wafer Sales。

目前 AI 事業部經營的重點，專注於將 VHM™ 導入 AI/ HPC 等應用市場。愛普科技的 VHM™ 是把 memory 疊在 SoC 上，為客戶提供更高的頻寬、更低的功耗的記憶體解決方案，相較目前 solution 的效能功耗比有很大的優勢。我們之前向各位先進報告過，目前與客戶有數個 POC 的案子正在順利進行當中。

在挖礦市場的部分，與客戶合作的新一代礦機，效能與功耗比在市場上是大幅領先競爭者，第一季已經進入量產，對今年 AI BU 營收將會有顯著的貢獻。

另外，在前次報告中我們也提到了 S-SiCap™ 的 IP 也成功應用在 2.5D 先進封裝的 interposer 上，已經有數個客戶採用並且已經 Tape-out，也持續有新的客戶在與我們規格討論當中，隨著進入量產，預期在今年下半年會開始有一些營收的貢獻。

再來，最後我想 AI BU 在今年隨著新的世代礦機進入量產、部分主流應用專案驗證完成、以及 Silicon interposer 進入量產，今年將會重回成長的軌道。

最後請董事長針對未來展望的部分向各位投資先進做報告。

陳文良 董事長

各位投資先進下午好。我是董事長兼執行長陳文良。我來總結一下第一季的表現，也跟大家報告我們對未來展望的一些看法。

2024 年第一季營收受季節性和客戶庫存的影响，相較去年第四季下降了將近 36%。其中下滑比較大的一部分是 IoT 的 Connectivity segment。如剛才總經理說明的，這個 Segment 因為客戶庫存偏高而需求暫時低迷。Connectivity 是我們 IoT 傳統市場之一。雖然短期有些庫存壓力，市場還是在成長的。我們認為 Connectivity 的庫存調整完成之後還會回到原來的趨勢。

從毛利率的角度看，第一季毛利率較上一季進一步提高了兩個百分點。毛利率的提升主要來自兩個因素，第一是 Connectivity 營收下降，這個 Connectivity segment 的毛利低於 IoT 的平均水平。第二個因素是 AI BU 的營收有回升。如我們一直說的，長期來看，隨著 AI BU 營收回升，IoT 產品附加價值增加，我們對長期穩中有升的毛利率趨勢的期望保持不變。

這一季的一個亮點是 AI BU VHM™ Wafer Sales 開始回升了。這個 Wafer Sales 來自新一代的加密貨幣挖礦機。這個市場雖然不是我們的重點，但是我們還會持續經營，保持我們技術和市占率領先地位。這個市場給我們一個很好的技術驗證和技術升級的機會。從這個市場學習到的 VHM™ 技術會逐步走向主流應用。

下面我來說明一下盈利的狀況。這一頁上，左邊淺綠色的是營業利益。第一季較上一季因為營收減少，營業費用小幅增加，所以營業利益減少。愛普科技的營收成長仍然是營業利益成長的主要驅動力，也是經營團隊主要的 KPI 之一。

業外收支主要來自外匯兌換利益和利息收入，本季總共 3.6 億。

那這一頁是我們的淨利趨勢。第一季業外收入的增加彌補了營業利益的減少，淨利和第四季相當。

最後，針對愛普的未來展望，我想跟各位做一個總結。

先說明一下 IoT BU。IoT BU 在近期仍然會受季節性和 Connectivity 庫存的影响，我們預計庫存去化在未來一兩季會完成。上一季法說會我們已經說明了新一代 IoTRAM™ 介面的推出，這個新介面大幅降低了功耗，可以讓外接的 IoTRAM™ 的功耗接近內建的 SRAM，可以取代內建 SRAM，在第一季已經完成了兩個客戶的 Spec-In，還有不少客戶在積極地評估。這個新介面會是 IoTRAM™ 未來成長的動力之一。

AI BU 的 Wafer Sales 隨著新一代的加密貨幣挖礦機的量產有重新啟動，但是這個市場較兩年之前已經縮水了不少，我們預計這個市場會持續有波動，但是更新換代會持續進行。

但是，像我剛才說的，非挖礦的 HPC 才是我們發展的重點。POC 項目進展順利，第一個 POC 項目已經完成了一半以上的驗證，今年還會有一些新的 POC 項目會啟動，我們也期待一些產品 Design-In 的機會。

S-SiCap™ 的應用按照服務模式和商業模式分成兩塊。第一塊是 S-SiCap™ 的 Interposer，由 AI BU 負責，出貨的形態是整片的 Wafer，商業模式是在設計階段收 NRE，量產階段收 Wafer Sales。我們也有客戶直接向 Foundry 下單，在這種情況下我們收 Royalty。這一塊業務已經逐漸上正軌，有幾個客戶已經在產品驗證階段。

第二塊是 Discrete 或者分離式 S-SiCap™，由 IoT 事業部負責，出貨的形態是經過後段

加工，已經切割的 Die。商業模式是傳統的貨物銷售，這一塊的最新情況是在嵌入 Substrate 這個應用領域有很大的進展，不止一家一線的 Substrate 供應商都有一些正面的驗證反饋。這一塊應用市場是下一代高功率 GPU 和 AI 加速器，單片功率會在一千瓦以上。我們做的 Embedded Substrate 裡面的 S-SiCap™ 在行業內還比較新，我們應該是第一家可以提供這個產品的公司。

另外，公司也在積極評估一些 3DIC 方面的投資案，其中包含堆疊、新設計概念、還有新架構的一些投資機會。在適當的時候我們會做一些細節的披露。

總結起來，我們對前景越來越看好，我們會加大投資力度，掌握好機會。

謝謝，歡迎大家提問！

Q&A

謝謝董事長。本次的簡報到這裡告一個段落，接下來進入問答階段，請各位投資朋友於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆，謝謝。

問題：請問公司怎麼看第二季及下半年的市場狀況？對於營收的預期？

回答：洪志勳 總經理

我們現在看起來預期是下半年的營收會比今年上半年好。

問題：請問毛利率能否維持第一季的水準或再進一步向上推升？

回答：洪志勳 總經理

IoT 的毛利率會依著產品組合的調整而會有一些變動，但是隨著 AI BU 的營收會逐漸增加在今年，整體的毛利率還是有機會提升的。

問題：請問 IoT 的 TAM？公司怎麼看 IoTRAM™的未來成長？

回答：洪志勳 總經理

IoT 是一個很大的市場，那有一些應用的記憶體，現在還是用 Build-in 的 SRAM 或者是標準型的 DRAM，那我們的 IoTRAM™經營到的部分只是這整個市場一部分的應用領域，還有很大的一個成長空間。

我們一直在做的就是推出更具成本以及效能競爭力的產品去取代客戶原有的記憶體方案。我想，我們對於未來的成長是樂觀的。

問題：可以說明 IoT 產品線的新規格或新應用方向嗎？營收有機會隨之成長？時點呢？

回答：洪志勳 總經理

IoT 線主要的新的產品，我們現在專注是在於幫助客戶在功耗以及性能上面，能夠做到再進一步的優化，那這些的專案也都在進行當中，這些產品我們是預計能在明年的下半年左右可以貢獻營收。

問題：CoWoS 為目前的主流，HBM 供不應求，愛普的 Wafer-on-Wafer 有何對應優勢？

未來有機會能夠取代 HBM 嗎？

回答：劉景宏 資深副總

CoWoS 指的是 2.5D 的先進封裝，HBM 跟邏輯主晶片透過 Silicon Interposer 封裝在一起。愛普的 Wafer-on-Wafer 是 3D 堆疊，它主要是將 DRAM 和邏輯主晶片透過 hybrid bonding 鍵合的方式堆疊在一起，因為間距比較小，所以主要的優勢有更高的頻寬和較低的能耗。是有取代一部分 HBM 市場的潛力。

問題：市場傳言 HBM4 因為高度因素，或將取消 3D Hybrid Bonding，對公司矽電容未來業務成長造成不利影響，請問公司的看法為何？

回答：陳文良 董事長

其實 HBM 目前沒有用 Hybrid Bonding，它是用 Micro Bumps 所堆疊的，但是確實 HBM4 因為高度的問題會走向 Hybrid Bonding，但是不管 HBM 是怎麼做的，我們現在做的 S-SiCap™ 的應用是在 2.5D 的 Substrate Interposer 或者是 Interposer 以下的一些結構，不會對我們的 S-SiCap™ 業務會有影響。反而是如果真的走到 HBM4，它的速度會更快，它對 S-SiCap™ 的需求會更大。

問題：之前提到 Si-Cap 預計占 24 年營收的 1~4%，還是一樣嗎？會有什麼再增長的契機？

回答：洪志勳 總經理

是的，我們目前看法還是一樣。Interposer 的客戶預計在今年下半年到明年年初會陸續地進入量產，也一直有新的案子在談，我們預期這部分的營收在明年會有機會再提升。

問題：請問愛普的 Stacking partner？

回答：劉景宏 資深副總

我們在台灣跟中國大陸都有密切合作的 Stacking partner。比如台積電跟力積電都是我們的 partner。

問題：請問 VHM™ 開始有 wafer 出貨，Wafer Sales 與 NRE 的占比？AI 的 revenue 會有機會超過 IoT 嗎？

回答：洪志勳 總經理

現在 VHM™ 有幾個案子剛進入量產，那主要是在礦機的部分，那預估今年 Wafer Sales 的占比會有機會接近或是超過 NRE。

那我們 VHM™ solution 的市場策略主要還是專注於主流應用的導入，雖然整體驗證時間會比較長，但是這個市場較 IoT 應用是更大，而且在快速地成長當中，長期來看我們認為 AI 的 revenue 是很有機會超越 IoT 的。

問題：請問在 AI 的 POC 專案，客戶是否會要求採用 advanced node 的 DRAM？愛普要如何因應？是否與三星/海力士這些大廠有合作機會？

回答：陳文良 董事長

在 POC 階段，目前我們沒有需要採用 advanced DRAM，但是未來在有些應用，我們主要是要看客戶的需求，如果客戶有需求、需要 advanced node 的 DRAM，我們就會有機會跟三大廠合作。

問題：之前法說會提到的幾個 IPD 的方案，可否說明一下目前與客戶的合作情形？

回答：洪志勳 總經理

S-SiCap™ 嵌入 substrate 的 project 現在我們正在順利地進行當中，客戶正在驗證的階段，最近也有一些針對量產的一些討論。那 S-SiCap™ Interposer 已經有幾個 project 已經 Tape-out，許多的設計也在順利進行當中，這個部份我們剛剛有提過，我們預計量產的時間大概在第四季到明年的 Q1 之間。

問題：請教公司派對於股價被大砍有什麼看法呢？會實施庫藏股嗎？

回答：林郁昕 財務長

資本市場股價的波動，站在公司的角度我們基本上是尊重的；那至於是否會實施庫藏股，這個部分我們會再進一步規劃，不過目前倒並沒有這樣子的想法。

問題：Interposer 的 business model 為何？何時會放量？

回答：劉景宏 資深副總

Interposer 的營收包括了 IP incensing/ NRE 以及 Wafer Sales，這是現在 AI BU 主要的 business model，目前 Interposer 有許多的設計案正在進行，我們預估量產的時間約莫會落在第四季左右。

問題：請問本季費用率超過 3 成，營業費用還會再增加嗎？

回答：林郁昕 財務長

費用率會上升主要是因為第一季營收較低所導致的，營業費用並沒有明顯地變化；隨著營收的回升，我們預期費用率也會隨之下降。

**問題：陳董現在也擔任來頡的董事長，請問雙方目前合作的進展？關係是否還會再進一步推
進？**

回答：陳文良 董事長

我們跟來頡的合作看的是長期的，在短期我們還在互相了解雙方在技術和市場上的優劣勢。長遠來看，我們希望能在 3DIC 的電源方面做出一些更好的產品。

問題：Interposer 的主要客戶類型？客戶主要地區別？

回答：洪志勳 總經理

Interposer 主要的應用還是 AI 的應用上面，歐美以及中國大陸的客戶都有。

問題：Interposer 主要合作的 FAB 是？除了 TSMC，有其他的競爭者有類似技術嗎？

回答：陳文良 董事長

我們生產 Interposer 合作的主要對象是力積電(PSMC)。我們做的是帶電容的 interposer，那這一類帶電容的 interposer，目前在市場上，除了台積還有我們之外，目前還沒有看到其他有競爭力的 solution。

問題：中國市場內捲趨勢明顯，愛普是否會受到影響？

回答：洪志勳 總經理

我想這點我們並不太擔心，因為市場短期價格的波動是難免的，那愛普的 Solution 是最能夠幫助客戶贏得市場，還有就是我們新世代的 IoTRAM™我們也持續與客戶密切地合作當中，在這個市場競爭力我們愛普是有競爭優勢的。

問題：AI POC 專案的主要客戶類型及地區別為何？目前專案的進展情形？

回答：劉景宏 資深副總

AI POC 專案目前主要的客戶還是歐美地區的主流客戶，目前專案依照進度開發順利進行當中。

問題：董事會這次決議投資子公司 APware 1,000 萬美元是 GDR 部分資金的運用嗎？此項投資對愛普的利益為何？

回答：林郁昕 財務長

這個主要是在轉投資架構上的一個整理，我們是打算將 APware 定位為海外投資的控股公司，統籌海外投資項目的執行、追蹤、管理以及向對外投資案主管機關的申報作業，那是有機會使用到 GDR 的部分資金，主要是要讓愛普能更有系統、有架構的來管理跨國策略性的投資。

問題：AI 第一季開始有 Wafer Sales，主要是應用在礦機上？有其他的應用嗎？

回答：劉景宏 資深副總

AI BU 第一季的 Wafer Sales 主要是礦機應用的出貨為主，還有一些少量的 Interposer 工程驗證的 wafer，就主要是這兩個部分。

問題：請問有提到現在新一代 VHM™在加密貨幣應用開始出貨，主要還是應用在以太幣嗎？之前共識機制改變的影響已經淡化了嗎？

回答：劉景宏 資深副總

我們客戶新一代的礦機主要應用在以太經典，就是 ETC 這個幣種，以太經典 ETC 相較於先前共識機制改變前的以太幣，那時候稱 ETH，確實市場是小了很多，但是還是有一定的規模，市場現在還有一些小型的幣種，我們目前 VHM™是記憶體方案最好的一個 solution。

問題：請問本季 IoT 與 AI 的營收占比各是多少？預期全年度占比？

回答：洪志勳 總經理

第一季 AI 的占比大約是十多個 percent 左右，我想隨著幾個 project 進入量產，Wafer Sales 的貢獻會增加，AI 事業部營收會再進一步地提升，但是在全年度的營收占比我們現在是比較不好估計的。

問題：請問力積電銅鑼新廠開幕時，黃董有提到會投入 CoWoS Interposer 中介層，每月有數千片的產出，請問這會用到愛普的技術嗎？

回答：劉景宏 資深副總

是的，力積電的 CoWoS Interposer 是跟愛普合作，並有 License 愛普的 IP。

問題：日前洪總有提到，高階手機及 HPC 晶片的應用趨勢，我們新一代的 S-Sicap™ Gen3 在市場上極具優勢，那請問未來 AI 手機導入應用的機會大嗎？目前是否已有應用的成果跟訂單？

回答：洪志勳 總經理

我們對 S-SiCap™ 在手機以及 HPC 應用趨勢方面的看法並沒有改變。那至於 AI 手機，我們現在還沒有比較瞭解到 AI 手機硬體的設計方案，所以這部份我們比較難 comment。但是我們認為 AI 手機必定對性能的要求會更高，對 S-SiCap™ 的需求也只會更多。

問題：前次法說有提到新世代 VHM™ 搭載 AI 礦機以及 S-Sicap™ 的量產，均在第二季會有較明顯的營收貢獻，目前維持這樣的進度嗎？

回答：洪志勳 總經理

目前的進度跟我們的預期並沒有太大的變化。新一代 VHM™ 的礦機已經量產，第一季已經開始有一些營收。AI 加速器的應用我們還在努力當中。那 S-SiCap™ 進展的部分，我們之前也提到了很多，我們已經說明過了，謝謝。

問題：請問今年 AI BU 營收主要成長來自哪個部分？

回答：劉景宏 資深副總

剛剛跟各位報告過，主要還是在礦機市場的回溫，我們 Wafer Sales 這部分會有明顯的可能增加，當然還有一些 POC 的案子專案認列，我們有部份的營收會在今年發生。

問題：請教 Q1 營收受季節性因素影響而下滑，季節性因素除了剛剛提到的營業天數較少，還有哪些其他因素？

回答：洪志勳 總經理

其實第一季的需求減少的主要因素，除了天數少以外，在整個需求的 cycle 裡面，主要需求的高峰在第三季，在第四季的 Christmas 以及在第一季的年初春節以及新年的效應，這邊的需求會比較大，那這部分的廠商的備貨，通常都會在第四季或第三季都已先提前拿了，所以在傳統上面，第一季的需求一般是比較淡的。

問題：近期記憶體市場回溫，VHM™市場是否能受惠呢？

回答：陳文良 董事長

VHM™的市場跟記憶體的行情沒什麼太大關係，我們反而是跟 AI 的行情比較有關係，那 AI 如果越熱，我們的客戶就越願意採用高性能的 VHM™的方案，所以最近記憶體的變化對我們應該是沒有什麼太大的影響。

謝謝各位的參與，問答階段在此告一個段落，會後若有其他的問題，各位可以聯繫本公司 IR 團隊。

謝謝各位的參與，今天的會議到此結束，謝謝！

聲明

若逐字稿內容與法說會現場陳述內容有不一致之處，應以法說會現場陳述內容為準。

上述訊息所提供對於產業及本公司前景之預測，係根據目前營運及公開資訊所做出之判斷，相關內容具風險與不確定性，任何外在環境的改變均可能影響公司實際營運與財務狀況。

上述訊息中所提供之資訊，不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述，本公司亦不會因任何新的資訊或事件而更新相關資訊。